

반도체 소부장 (Overweight)

주간 해외 기업 실적 리뷰: AI의 편에 서야 살아남는다







반도체 산업 포인트

Texas Instruments, ASMP, BE Semiconductor, 그리고 STMicroelectronics의 실적을 리뷰하며 이번 하반기도 AI 관련 매출 비중이 높은 기업이 호실적을 기록할 전망. 차량용과 산업용 반도체 회복세 더딘 가운데 AP 주문도 불확실성 지속

반도체 소부장 임소정_02)368-6154_sophie.yim@eugenefn.com

- 금주 실적을 발표한 해외 반도체 업체들을 통해 하반기 최종 응용처별 시장 분위기 파악해볼 필요
- **Texas Instruments**
2Q25 실적은 매출 44.5억 달러(YoY +16.4%, QoQ +9.3%), 영업이익 15.6억 달러(YoY +25.2%, QoQ +18.2%)를 기록하여 컨센서스를 상회. 2분기 pull-in으로 인해 3분기 가이던스 보수적으로 제시
- **STMicroelectronics**
2Q25 실적은 매출 27.7억 달러(YoY -14.4%, QoQ +9.9%), 영업적자 1.3억 달러(YoY 적전, QoQ 적전)를 기록. 2Q 기준 10년 만에 첫 적자로 손상차손과 구조조정 비용 등이 반영. 차량용 반도체 수요 회복 사이클 기대
- **BE Semiconductor**
2Q25 실적은 매출 1.5억 유로(YoY -2.1%, QoQ +2.8%), GPM 63.3%(YoY -1.7%p, QoQ -0.3%p)를 기록하여 컨센서스를 상회. 로직뿐만 아니라 메모리 반도체용 하이브리드 본딩 장비 시장 진출하며 2H25 주문 증가 기대
- **ASMP**
2Q25 실적은 매출 4.4억 달러(YoY +2.1%, QoQ +8.5%), 영업이익 2,153만 달러(YoY +25.2%, QoQ +5.6%)를 기록하여 컨센서스에 부합. TC Bonder의 매출 기여도가 가장 높았고, 와이어 본딩 장비도 중국과 OSAT 고객사 중심으로 강세를 보임
- 결론적으로 미·중 지정학 리스크 노출이 적거나 전체 매출 가운데 AI항 비중 클수록 회복도 빠르고 그 폭도 더 클 것으로 예상. 주목해야 할 국내 종목: DB하이텍, 한미반도체, 한화비전

ASMP의 최종 응용처별 매출 비중으로 보는 유망한 시장

	Automotive	Communication	Computers	Consumer	Industrial	Others
						
Group Revenue						
1H 2025	~15%	~13%	~30%	~12%	~8%	~22%
1H 2024	~24%	~17%	~7%	~14%	~14%	~24%

자료: ASMP, 유진투자증권

I. 해외 반도체 기업 실적 발표

Texas Instruments: Tone changed, but still strong

2 분기 pull-in
수요로 보수적인
3 분기 가이드언스

Texas Instruments 의 2Q25 실적은 매출 44.5 억 달러(YoY +16.4%, QoQ +9.3%), 영업이익 15.6 억 달러(YoY +25.2%, QoQ +18.2%)를 기록하여 컨센서스를 상회했다. 사업부별 매출 성장률을 보면 산업향은 YoY +10%, QoQ +10% 중반, 차량용은 YoY +5%, QoQ -5%, 소비자향은 YoY +25%, QoQ +5%, 통신 장비향은 +YoY 50%, QoQ +10%를 기록. 중국 정부의 반덤핑 조사로 인한 중국 반도체 설계 업체들의 차량용 반도체 주문 감소가 차량용 사업부 역성장에 영향을 준 것으로 분석된다.

3Q25 가이드언스는 매출 44.5~48.0억 달러, EPS \$1.36~1.60로 중간값 컨센서스(46.5 억 달러)를 소폭 하회하는 수준으로 제시했다. 보수적 가이드언스를 제시한 배경으로는 차량용 반도체 사업부의 약한 회복세와 잔존하는 관세와 지정학 리스크가 지목된다. 2 분기에는 중국 대상 145%의 관세가 언급되는 등 지금보다 관세發 불안감이 더 컸기 때문에 강한 pull-in 수요가 동반되었다. 이에 3 분기에는 상대적으로 낮은 수준의 주문과 이에 따른 생산이 예상된 것으로 추정된다.

통상 아날로그 칩 제조사로 알려졌지만 AI 시장의 데이터 센터향 매출이 늘어나고 있는 추세이다. 50%가 넘는 성장률을 기록하고 있으며, 기존의 범용 대신 맞춤형 제품의 비중도 올라오는 중이다. 맞춤형 제품들은 지난해 미 정부로부터 받은 16 억 달러 규모의 보조금으로 투자된 텍사스 셔먼의 팹에서 생산된다. 하지만 결론적으로 약한 3 분기 가이드언스가 제시되면서 주가는 실적 발표 후 8% 하락했다.

도표 1. Texas Instruments Financial Data

결산기(12 월)	1Q25A	2Q25P	3Q25F	2024A	2025A
매출액(십억달러)	4.07	4.36	4.65	15.6	17.6
매출총이익(십억달러)	2.31	2.48	2.68	9.1	10.2
영업이익(십억달러)	1.32	1.48	1.67	5.5	6.1
당기순이익(십억달러)	1.18	1.24	1.36	4.8	5.1
매출 YoY	11.2%	14.1%	12.0%	-10.7%	12.7%
GPM	56.8%	56.9%	57.6%	58.1%	57.6%
OPM	32.4%	33.9%	35.9%	35.0%	34.8%
ROE	28.3%	30.4%	33.2%	28.4%	30.6%
Fwd.12M P/E(x)					29.9
주가 YTD(%)					-0.7

자료: Texas Instruments, 유진투자증권

STMicroelectronics: 10 년 만에 첫 2 분기 적자 기록

비용 절감으로
쇄신에 나서는
STMicro

STMicroelectronics 의 2Q25 실적은 매출 27.7 억 달러(YoY -14.4%, QoQ +9.9%), 영업적자 1.3 억 달러(YoY 적전, QoQ 적전)를 기록하여 영업 손실에도 불구하고 매출은 컨센서스를 상회했다. 적자를 기록한 배경으로는 1.9 억 달러의 손상차손과 구조조정 비용 등이 있었으며 이는 10 년 만에 첫 2 분기 적자이다. 사업부별로는 아날로그 및 센서 11.3 억 달러(YoY -15.2%), 파워 및 discrete 4.5 억 달러(YoY -22.2%), 임베디드 8.5 억 달러(YoY -6.5%), RF 및 옵티컬 제품 3.4 억 달러(YoY -17.9%)를 기록하여 모두 전년대비 매출이 감소했다.

3Q25 가이드스는 매출 31.7 억 달러로 컨센서스인 30.8 억 달러를 상회하는 수준으로 제시했다. 경쟁사로 알려진 인피니언과 NXP와 달리, 당사는 원래 자체 제작 매출 비중이 계약 제조 비중보다 높기 때문에, 다운사이클에는 가동률 하락과 인건비 상승의 악영향을 더 많이 받는 구조이다. 하지만 차량용 반도체 사이클 회복 구간에서는 매출 반등의 강도가 강해질 것으로 전망한다. 또한 작년부턴 캐파 구조를 재구성하고, 일자리 감축 등을 통한 비용 절감을 계획한 바 이익단에서의 개선을 기대해볼 수 있다. 한편 실적 발표 후 주가는 11% 하락했다.

도표 2. STMicroelectronics Financial Data

결산기(12 월)	1Q25A	2Q25P	3Q25F	2024A	2025A
매출액(십억달러)	2.52	2.74	3.08	13.3	11.6
매출총이익(십억달러)	0.84	0.90	1.08	5.2	3.9
영업이익(십억달러)	0.00	0.05	0.21	1.7	0.5
당기순이익(십억달러)	0.06	0.10	0.23	1.6	0.7
매출 YoY	-27.4%	-15.2%	-5.2%	-23.3%	-13.0%
GPM	33.3%	32.8%	35.1%	39.3%	33.9%
OPM	0.0%	1.8%	6.8%	12.7%	4.7%
ROE	1.4%	2.3%	5.2%	9.1%	3.7%
Fwd,12M P/E(x)					27.0
주가 YTD(%)					27.2

자료: STMicroelectronics, 유진투자증권

BE Semiconductor: 하이브리드 본딩 장비 기대감 유효

로직 반도체를
넘어선 메모리
하이브리드 본딩
준비

BE Semiconductor 의 2Q25 실적은 매출 1.5 억 유로(YoY -2.1%, QoQ +2.8%), GPM 63.3%(YoY -1.7%p, QoQ -0.3%p)를 기록하여 컨센서스를 상회했다. 마진을 하락은 제품 믹스의 악화와 비우호적인 외환 환경에서 기인했다. 주문 금액은 1.3 억 유로(YoY -30.9%, QoQ -3.0%)로 시장의 기대를 하회했는데, 하이브리드 본딩과 모바일 관련 장비 주문이 감소한 영향이다.

3Q25 가이드는 125.9~140.7 억 유로(중간값 133.3 억 유로)로 전분기에 제시한 148.1 억 유로에서 하향했다. 여전히 어려운 외환 환경과 시장 상황이 지속되나, AI 어플리케이션을 위한 하이브리드 본딩과 2.5D 패키징 분야에서의 탄탄한 입지를 유지할 수 있을 것으로 전망한다. 또한 2024년 7월 채권 발행으로 현금 보유액이 전년대비 +90% 증가한 4.9 억 유로를 기록하면서, 전략적인 자산 매입과 R&D 투자가 가능한 상황이다.

하이브리드 본딩 장비에 대한 주문은 2H25가 1H25와 2H24보다 강할 것으로 전망한다. 기존 주력 영역인 로직 분야뿐만 아니라 메모리 반도체를 위한 장비도 준비 중인 것으로 분석된다. 그리고 3분기의 매출 예상치가 하향된 이유는 업황이 어렵다고 전망되기 때문이 아니라, 시스템 단위의 장비 주문이 3분기 말에서 4분기 초에 걸칠 수 있다는 가능성이 반영됐기 때문이다. BESi에 의하면 하이브리드 본딩 기술이 도입된 HBM은 2027년 말까지 쿼 테스트를 하고, 2027년부터 대량 양산으로 넘어갈 것으로 예상한다.

도표 3. BE Semiconductor Financial Data

결산기(12월)	1Q25A	2Q25P	3Q25F	2024A	2025A
매출액(십억달러)	0.15	0.18	0.19	0.7	0.7
매출총이익(십억달러)	0.10	0.11	0.12	0.4	0.5
영업이익(십억달러)	0.04	0.06	0.06	0.2	0.2
당기순이익(십억달러)	0.03	0.05	0.05	0.2	0.2
매출 YoY	-6.3%	12.5%	11.8%	4.8%	12.1%
GPM	66.7%	61.1%	63.2%	65.2%	64.9%
OPM	26.7%	33.3%	31.6%	31.8%	32.4%
ROE	22.2%	71.4%	-	40.8%	37.7%
Fwd.12M P/E(x)					40.5
주가 YTD(%)					-6.5

자료: BE Semiconductor, 유진투자증권

ASMPT: TC Bonder 로 야금야금

TC Bonder
매출 기여도
지속 증가하는 중

ASMPT의 2Q25 실적은 매출 4.4억 달러(YoY +2.1%, QoQ +8.5%), 영업이익 2,153만 달러(YoY +25.2%, QoQ +5.6%)를 기록하여 컨센서스에 부합했다. BB율(Book-to-Bill Ratio)가 2분기 연속 1.1대를 기록한 점은 긍정적이거나 비우호적인 외환 환경으로 GPM이 39.7%로 전분기(40.9%)와 전년(40.0%)대비 하락했다. 사업부별로 보면 반도체 솔루션이 2.6억 달러(YoY +21.1%, QoQ +0.8%), SMT 솔루션이 1.8억 달러(YoY -16.7%, QoQ +22.6%)를 기록했다.

반도체 솔루션 사업부에서는 TC Bonder의 매출 기여도가 가장 높았고, 와이어 본딩 장비도 중국과 OSAT 고객사 중심으로 강세를 보였다. 다만 TC Bonder 주문은 AP 생산 관련 불확실성이 반영되어 감소했고, R&D 비용 증가로 마진율은 한 자릿수로 하락했다. SMT 솔루션 사업부의 경우 차량용과 산업용 제품의 판매 부진이 중국 및 AP 향 호실적을 상쇄했지만 마진은 개선됐다.

3Q25 가이던스는 4.45억~5.05억 달러로 컨센서스(중간값 4.70억 달러)를 소폭 상회했다. AP 관련 장비 매출이 견조한 가운데 SMT 사업부 실적이 개선될 것이라는 기대감이 반영되었다. 단기적으로 차량용과 산업용 시장은 수요 약세가 지속될 것으로 예상되나, 중국과 AI 데이터센터 모멘텀은 유효하다.

도표 4. ASMPT Financial Data

결산기(12월)	1Q25A	2Q25P	3Q25F	2024A	2025A
매출액(십억달러)	0.40	0.44	0.47	1.7	1.8
매출총이익(십억달러)	0.16	0.18	0.19	0.7	0.7
영업이익(십억달러)	0.02	0.03	0.04	0.1	0.1
당기순이익(십억달러)	0.01	0.02	0.02	0.0	0.1
매출 YoY	0.0%	2.3%	9.3%	-9.6%	4.7%
GPM	40.0%	40.9%	40.4%	40.0%	41.6%
OPM	5.0%	6.8%	8.5%	5.3%	7.3%
ROE	4.1%	-	-	2.0%	4.5%
Fwd.12M P/E(x)					25.3
주가 YTD(%)					-5.9

자료: ASMPT, 유진투자증권

II. 결론

돈냄새를 잘 맡아야 한다

종합적으로, 여전히 시에 매출이 어느 정도 관련이 있는지에 따라 실적과 가이던스가 갈리는 모습이다. TI 의 경우 사이클 면에서 반등하는 구간을 지날 수 있으나 중국의 반덤핑 조사로 인해 중국 시장에서의 점유율이 크게 빠질 가능성이 높다. 이에 대한 반사 수혜를 받는 기업으로는 중국 팹리스 고객들을 다수 보유하고, 관세를 비롯한 미·중 분쟁으로부터 영향이 적은 DB 하이텍을 들 수 있다.

하이브리드 본딩 장비 시장이 점차 커지면서 메모리 TC Bonder 에서 시작한 한미반도체와 한화비전 이외에도 로직용 하이브리드 본딩 장비만 개발하던 BE Semiconductor 도 메모리용 하이브리드 본딩 장비 시장에 본격적으로 뛰어든 전망이다. 장기적으로는 D2W에서 W2W 장비로의 개발 속도에 따라 초기 시장 점유율이 결정될 것으로 판단한다.

Compliance Notice

당사는 자료 작성일 기준으로 지난 3개월 간 해당종목에 대해서 유가증권 발행에 참여한 적이 없습니다

당사는 본 자료 발간일을 기준으로 해당종목의 주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다

당사는 동 자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다

조사분석담당자는 자료작성일 현재 동 종목과 관련하여 재산적 이해관계가 없습니다

동 자료에 게재된 내용들은 조사분석담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성되었음을 확인합니다

동 자료는 당사의 제작물로서 모든 저작권은 당사에 있습니다

동 자료는 당사의 동의 없이 어떠한 경우에도 어떠한 형태로든 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다

동 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료 및 정보로부터 얻어진 것이나, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다.

따라서 어떠한 경우에도 자료는 고객의 주식투자의 결과에 대한 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다

투자기간 및 투자등급/투자의견 비율

종목추천 및 업종추천 투자기간: 12개월 (추천기준일 종가대비 추천종목의 예상 목표수익률을 의미함)

당사 투자의견 비율(%)

· STRONG BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +50%이상	0%
· BUY(매수)	추천기준일 종가대비 +15%이상 ~ +50%미만	98%
· HOLD(중립)	추천기준일 종가대비 -10%이상 ~ +15%미만	2%
· REDUCE(매도)	추천기준일 종가대비 -10%미만	0%

(2025.06.30 기준)